

## Infineon Technologies in Dresden Eckdaten

	<b>200-mm-Werk</b>	<b>300-mm-Werk</b>
Baubeginn:	Juli 1994	Mai 2000
Volumenproduktion:	August 1996	Dezember 2001
Mitarbeiter:	3.500	800
Investitionen:	1,5 Milliarden Euro	1,1 Milliarden Euro
Beteiligungen:	---	M+W Zander, 51 Millionen Euro Messegesellschaft Leipzig, 118 Millionen Euro
Reinraumfläche:	2 Module à 5.400 m <sup>2</sup>	1 Modul mit 8.840 m <sup>2</sup>
Reinraumklasse:	1	1.000 (FOUP*-Konzept)
DRAM-Technologie:	0,2 µm bis 0,14 µm	0,14 µm und kleiner
Logik-ICs:	0,17 µm und kleiner	
Produkte:	64-Mbit, 128-Mbit, 256-Mbit, Chips für mobile und drahtge- bundene Kommunikation sowie für Chipkarten	256-Mbit, 512-Mbit, 1-Gbit

\*FOUP = Front Opening Unified Pod